

会 場	〔Ⅰ〕 大阪 の 部		会場：大阪産業技術研究所 大講堂	
期 日	第 1 日：平成 30 年 7 月 26 日 (木)		第 2 日：平成 30 年 7 月 27 日 (金)	
受講受付	8 時 30 分 より		8 時 30 分 より	
時 間	テ ー マ	講 師	テ ー マ	講 師
9 時 25 分	開会挨拶	関西大学名誉教授 工学博士		
9 時 30 分		越智 光一氏		
9 時 30 分	自動車用接着剤(エポキシ樹脂系接着剤を中心に)の技術動向	サンスター技研株式会社 研究開発部 マネジャー	脂環式エポキシ樹脂関連の技術動向	株式会社ダイセル 有機合成カンパニー 研究開発センター エポキシ技術リーダー
10 時 30 分	自動車生産工程で使用される接着剤の概要とその工程材料で用いられるエポキシ系接着剤の最新の技術動向について紹介する。	奥野 辰弥氏	当社が製造・販売を行っている脂環式エポキシ樹脂の製品紹介及び脂環式エポキシ樹脂の応用例について紹介する。	鈴木 弘世氏
10 時 30 分	エポキシ樹脂硬化剤イミダゾール及び四国化成のエポキシ樹脂改質剤について	四国化成工業株式会社 化学品研究・開発 機能材料チーム リーダー 理学博士	重防食塗料 水性化の状況と今後について	関西ペイント株式会社 塗料事業部 技術開発第 3 部 部長
11 時 30 分	エポキシ樹脂硬化剤としてのイミダゾールの硬化機構や使用方法について報告する。また、四国化成が展開している各種樹脂改質剤(チオール系硬化剤、密着性付与剤、カチオン硬化性エポキシ樹脂)について報告する。	熊野 岳氏	重防食塗料分野における V O C 削減対策として各塗料製造会社は、水性塗料の開発と実績を積み上げてきた。今回水性塗料の標準化(JIS)の概要と施工実績を紹介する。	末廣 明氏
	休	憩	休	憩
11 時 40 分	土木建築用途のエポキシ樹脂の最近の技術動向について	コニシ株式会社 浦和研究所 研究開発第 4 部	半導体パッケージ基板向け層間絶縁材料の技術動向	味の素株式会社 バイオ・ファイン研究所 主席研究員
12 時 40 分	土木建築用途に使用されるエポキシ樹脂系接着剤の概要と最近の技術動向について説明する。	尾藤 陽介氏	半導体パッケージ向け層間絶縁材料の技術開発動向について説明する。	川合 賢司氏
12 時 40 分 13 時 15 分	昼	食	昼	食
13 時 15 分	電子材料用途向けエポキシ樹脂／硬化剤の技術動向	D I C 株式会社 ポリマ第一技術本部 ポリマ技術 5 グループ 研究主任	パワーデバイス関連材料	日立化成株式会社 イノベーション推進本部 マーケティングセンタ 部長代理
14 時 15 分	近年電子部品の軽薄短小化や高速通信対応に向けたエポキシ樹脂／硬化剤の樹脂設計思想と開発動向について紹介する。	林 弘司氏	パワーデバイス／モジュールの高パワー密度のために必要な構成部材に求められるパフォーマンス及び当社が提案する新規パワーモジュール構造／部材	戸川 光生氏 岡田 誠氏
	休	憩	休	憩
14 時 25 分	分子接合技術による次世代配線形成、放熱技術	株式会社東芝 部品材料事業統括部 主幹 工学博士 八甫谷 明彦氏	自動車部品の実装技術動向とエポキシ樹脂封止材料	株式会社日立製作所 研究開発グループ 材料イノベーションセンタ 主管研究員 工学博士
15 時 25 分	分子接合技術は、従来の接着、接合の概念とは全く違う、「もの」と「もの」を分子レベルで強固につなぐことから、プロセス変革とプロダクト製品の付加価値を生み出すことが期待できる。	いおう化学研究所 森 邦夫氏	自動運転車や電気自動車向けの電気電子実装技術では、エポキシ樹脂封止材料が用いられ高性能化・高信頼化に貢献している。自動車および車載機器の動向と材料の開発状況を紹介します。	石井 利昭氏
15 時 25 分	ポリマーブレンドを活用したエポキシ樹脂系複合材料の構造形成と機能発現	兵庫県立大学 大学院工学研究科 化学工学専攻 教授 工学博士	CFRPの自動車分野における最近の技術動向	金沢工業大学 大学院工学研究科 高信頼ものづくり専攻 教授
16 時 25 分	エポキシポリマーブレンド* 及びそのフィラー系複合材料に関し、相構造・フィラー分散制御と機能発現について述べる。	岸 肇氏	自動車産業において、スポーツカーだけでなく環境対応車両にも使われ始めているCFRPについて最近の動向、技術を紹介する。	影山 裕史氏

技 術 講 座 第 四 十 二 回 公 開

エポキシ樹脂及び応用技術の最近の動向

会 場	〔Ⅱ〕 東京 の 部		会場：DIC株式会社 本社 大会議室	
期 日	第 1 日：平成 30 年 8 月 2 日 (木)		第 2 日：平成 30 年 8 月 3 日 (金)	
受講受付	8 時 30 分 より		8 時 30 分 より	
時 間	テ ー マ	講 師	テ ー マ	講 師
9 時 25 分	開会挨拶	横浜国立大学 客員教授 工学博士 高橋 昭雄氏		
9 時 30 分				
9 時 30 分	電子材料用途向けエポキシ樹脂／硬化剤の技術動向	D I C 株式会社 ポリマ第一技術本部 ポリマ技術 5 グループ 研究主任	重防食塗料 水性化の状況と今後について	大日本塗料株式会社 塗料事業部門 取締役 執行役員 塗料事業部門長
10 時 30 分	近年電子部品の軽薄短小化や高速通信対応に向けたエポキシ樹脂／硬化剤の樹脂設計思想と開発動向について紹介する。	林 弘司氏	重防食塗料分野における V O C 削減対策として各塗料製造会社は、水性塗料の開発と実績を積み上げてきた。今回水性塗料の標準化(JIS)の概要と施工実績を紹介する。	山本 基弘氏
10 時 30 分	分子接合技術による次世代配線形成、放熱技術	株式会社東芝 部品材料事業統括部 主幹 工学博士 八甫谷 明彦氏	パワーデバイス関連材料	日立化成株式会社 イノベーション推進本部 マーケティングセンタ 部長代理
11 時 30 分	分子接合技術は、従来の接着、接合の概念とは全く違う、「もの」と「もの」を分子レベルで強固につなぐことから、プロセス変革とプロダクト製品の付加価値を生み出すことが期待できる。	いおう化学研究所 森 邦夫氏	パワーデバイス／モジュールの高パワー密度のために必要な構成部材に求められるパフォーマンス及び当社が提案する新規パワーモジュール構造／部材	戸川 光生氏 岡田 誠氏
	休	憩	休	憩
11 時 40 分	土木建築用途のエポキシ樹脂の最近の技術動向について	コニシ株式会社 浦和研究所 研究開発第 4 部	自動車部品の実装技術動向とエポキシ樹脂封止材料	株式会社日立製作所 研究開発グループ 材料イノベーションセンタ 主管研究員 工学博士
12 時 40 分	土木建築用途に使用されるエポキシ樹脂系接着剤の概要と最近の技術動向について説明する。	尾藤 陽介氏	自動運転車や電気自動車向けの電気電子実装技術では、エポキシ樹脂封止材料が用いられ高性能化・高信頼化に貢献している。自動車および車載機器の動向と材料の開発状況を紹介します。	石井 利昭氏
12 時 40 分 13 時 15 分	昼	食	昼	食
13 時 15 分	半導体パッケージ基板向け層間絶縁材料の技術動向	味の素株式会社 バイオ・ファイン研究所 主席研究員	脂環式エポキシ樹脂関連の技術動向	株式会社ダイセル 有機合成カンパニー 研究開発センター エポキシ技術リーダー
14 時 15 分	半導体パッケージ向け層間絶縁材料の技術開発動向について説明する。	川合 賢司氏	当社が製造・販売を行っている脂環式エポキシ樹脂の製品紹介及び脂環式エポキシ樹脂の応用例について紹介する。	鈴木 弘世氏
	休	憩	休	憩
14 時 25 分	エポキシ樹脂硬化剤イミダゾール及び四国化成のエポキシ樹脂改質剤について	四国化成工業株式会社 化学品研究・開発 機能材料チーム リーダー 理学博士 熊野 岳氏	自動車用接着剤(エポキシ樹脂系接着剤を中心に)の技術動向	サンスター技研株式会社 研究開発部 マネジャー
15 時 25 分	エポキシ樹脂硬化剤としてのイミダゾールの硬化機構や使用方法について報告する。また、四国化成が展開している各種樹脂改質剤(チオール系硬化剤、密着性付与剤、カチオン硬化性エポキシ樹脂)について報告する。		自動車生産工程で使用される接着剤の概要とその工程材料で用いられるエポキシ系接着剤の最新の技術動向について紹介する。	奥野 辰弥氏
15 時 25 分	ポリマーブレンドを活用したエポキシ樹脂系複合材料の構造形成と機能発現	兵庫県立大学 大学院工学研究科 化学工学専攻 教授 工学博士	CFRPの自動車分野における最近の技術動向	金沢工業大学 大学院工学研究科 高信頼ものづくり専攻 教授
16 時 25 分	エポキシポリマーブレンド* 及びそのフィラー系複合材料に関し、相構造・フィラー分散制御と機能発現について述べる。	岸 肇氏	自動車産業において、スポーツカーだけでなく環境対応車両にも使われ始めているCFRPについて最近の動向、技術を紹介する。	影山 裕史氏

エポキシ樹脂技術協会主催

第42回公開技術講座

エポキシ樹脂及び応用
技術の最近の動向

大阪：平成30年7月26日(木)・27日(金)

大阪産業技術研究所 大講堂

東京：平成30年8月2日(木)・3日(金)

DIC株式会社 本社 大会議室

主催 エポキシ樹脂技術協会

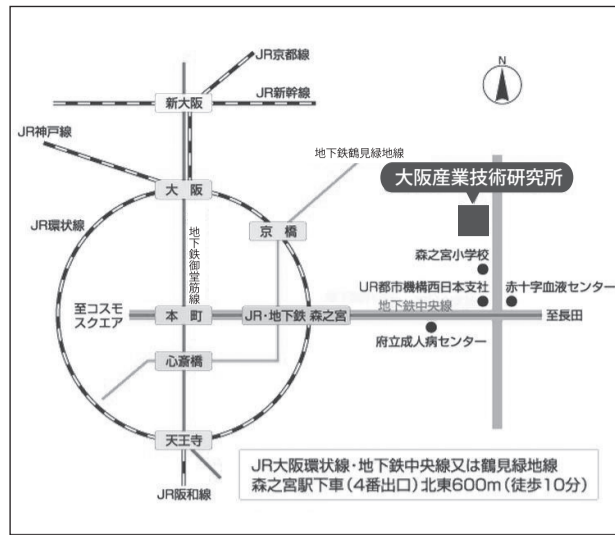
東京都新宿区市ヶ谷砂土原町1-2
〒162-0842 タイホービル 102号
電話 03-3260-1721
FAX 03-3235-9012
URL : <http://epoxygk.world.cocan.jp>

一般(非会員)お申込要領

1. 聴講料
35,000円(講演要旨集代、昼食代を含む)
2. 申込方法(締切り)大阪会場 7月24日
東京会場 7月31日
本案内状の申込書(東京、大阪、別々の用紙にご記入下さい)を協会宛郵送又はFAXにて連絡の上、聴講料を指定銀行に振込んで下さい。折返し聴講券及び領収書をお送り致します。開催前1週間以内にお振込の場合は聴講券及び領収書は当日会場受付にてお受け取り下さい。聴講料の請求書入用の場合は聴講申込書にその旨ご記入下さい。また、当協会のホームページからも申込できます。
<<http://epoxygk.world.cocan.jp>>
3. 申込先
東京都新宿区市ヶ谷砂土原町1-2
〒162-0842 タイホービル 102号
エポキシ樹脂技術協会 電話 03(3260)1721
FAX 03(3235)9012
4. 振込先
みずほ銀行市ヶ谷支店 普通口座 1124935
エポキシ樹脂技術協会
5. ご注意
尚、お振込の際は個人名でなく会社名を入れてお願い致します。個人名だけでは確認が困難で聴講券の発送に支障をきたす場合があります。
5. ご注意
聴講料の払戻しは致しませんので、お申込者にご都合のある場合は、代理の方が参加して下さい。また、講演要旨集は別売致しませんので、ご了承下さい。

(大阪会場) 大阪産業技術研究所 大講堂

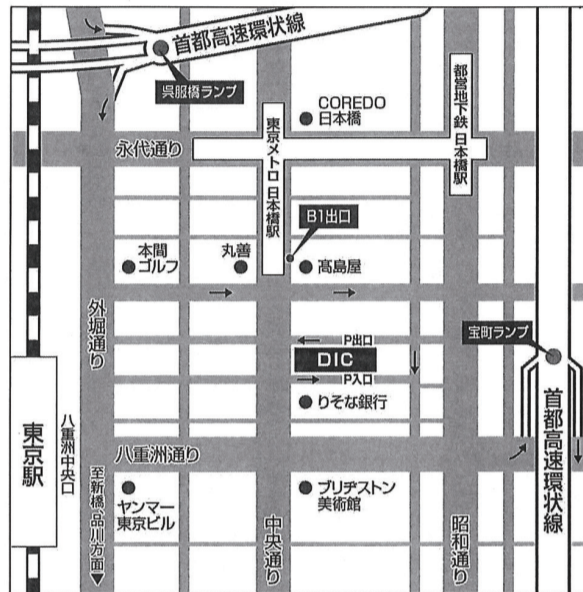
〒536-8553 大阪市城東区森之宮1-6-50



(交通) JR大阪環状線・地下鉄中央線又は鶴見緑地線
森之宮駅下車(4番出口)北東600m(徒歩10分)

(東京会場) DIC株式会社 本社 大会議室

〒103-8233 東京都中央区日本橋3-7 ディーアイシービル
TEL 03-6733-3000



会員お申込要領

会員区分	無料分	有料分
正会員	東京または大阪 1名無料	18,000円
維持会員及 特別維持会員	東京・大阪を合せて 2名無料	18,000円

2. 申込方法(締切り)大阪会場 7月24日
東京会場 7月31日

1) 無料分のお申込

各会員の当協会担当者(窓口)宛にお送りした**会員無料分申込書**に御記入の上協会宛お送り下さい。折返し聴講券をお送りします。

2) 有料分のお申込

聴講料(18,000円)以外は一般(非会員)と同じですので、右の一般(非会員)申込要領をご参照下さい。

※講演要旨集の事前配布

聴講申込みの方の内、希望者には送料受取人払いの宅配にて講演要旨集の事前配布を行います。ご希望の方は申込み書の所定欄に記入して下さい。

エポキシ樹脂技術協会主催
第42回公開技術講座

大阪 会場申込書 会員有料分・一般(非会員)

(左の会員・非会員の該当を○で囲んで下さい。)

貴社名	聴講者ご氏名	同左所属部署	聴講料
聴講券領収証送り先(1)	電話	聴講料請求書	要 不要
聴講券領収証送り先(2)	電話	講演要旨集事前配布(送料受取人払い)	要 不要
銀行振込予定 みずほ銀行市ヶ谷支店 平成30年 月 日	銀行振込予定 みずほ銀行市ヶ谷支店 平成30年 月 日	聴講料	円

エポキシ樹脂技術協会主催
第42回公開技術講座

東京 会場申込書 会員有料分・一般(非会員)

(左の会員・非会員の該当を○で囲んで下さい。)

貴社名	聴講者ご氏名	同左所属部署	聴講料
聴講券領収証送り先(1)	電話	聴講料請求書	要 不要
聴講券領収証送り先(2)	電話	講演要旨集事前配布(送料受取人払い)	要 不要
銀行振込予定 みずほ銀行市ヶ谷支店 平成30年 月 日	銀行振込予定 みずほ銀行市ヶ谷支店 平成30年 月 日	聴講料	円

2名以上の申し込みで聴講券の発行先が2カ所になる場合は聴講者氏名に(1)又は(2)を附して区別して下さい。

2名以上の申し込みで聴講券の発行先が2カ所になる場合は聴講者氏名に(1)又は(2)を附して区別して下さい。